# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-190873

(43) Date of publication of application: 22.07.1997

(51)Int.CI.

H05B 3/12

HO5B

(21)Application number : **08-000183** 

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND

CO LTD

(22)Date of filing:

05.01.1996

(72)Inventor: HIGASHIYAMA KENJI

# (54) MANUFACTURE OF SHEET HEATER UNIT

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a sheet heater unit having a positive resistancetemperature characteristic with excellent safety, by specifying the mixture material, and the coating and the baking conditions.

SOLUTION: At first, a carbon powder a metal membrane is coated, and a silicon resin are mixed with an organic solvent. The resultant mixture is coated on at least a pair of electrodes formed on the surface of a heat resisting insulating base making a part of the electrodes is superposed, so as to form a coat for heating. Then, it is baked at 250 to 450° C. As a result, since the substance coating a metal indicating the positive resistancetemperature characteristic, on the carbon powder indicating the negative resistancetemperature characteristic essentially, is used to the conductive particles, the electric resistance is smaller in the coating metal film side, and the majority of current flows to this side. Consequently, the resistance-temperature characteristic indicates the positive property by showing the characteristic of the metal film mainly, and it can be used as a safe heater unit generating no abnormal heating.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

. 特開平9-190873

(43)公開日 平成9年(1997)7月22日

(51)Int. Cl. e

識別記号

庁内整理番号

FΙ

TR 2/12

技術表示箇所

H 0 5 B 3/12

3/20

379

H05B

3/12 3/20 Z 379

審査請求 未請求 請求項の数3

OL

(全7页)

(21)出願番号

特願平8-183

(22)出願日

平成8年(1996)1月5日

(71)出願人 000005821

松下鏈器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 東山 健二

香川県高松市古新町8番地の1 松下寿電子

工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 滝本 智之 (外1名)

# (54)【発明の名称】面状発熱体の製造法

## (57)【要約】

【課題】 炭素粉束を導電粒子に用いた面状発熱体の改良に関するものであり、さらに詳細に述べると、従来の前記発熱体の抵抗ー温度特性が、NTC特性であったものを安全性に優れたPTC特性の発熱体の製造法を提供するものである。

【解決手段】 金属薄膜がコーティングされた炭素粉末と、絶縁性あるいは半導体性粉末と金属薄膜がコーティングされて無いグラファイト粉末と、シリコン樹脂ワニスと、有機ピヒクルとを混合し、該混合物を耐熱性絶縁性基板面に塗布乾燥後、250℃~450℃の範囲で焼結した発熱体被膜を有する面状発熱体を形成する。

(2)

特開平9-190873

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属薄膜がコーティングされた炭繁粉末 とシリコン樹脂を、有機溶剤と混合してなる混合物を、 耐熱性絶縁性基体の表面に形成された少なくとも1対の 色極にその一部が重なるように塗布し、発熱体用被膜を 形成し、次いでこれを250℃~450℃の温度で焼成 することを特徴とする零戦は正の抵抗一温度特性を有す る面状発熱体の製造法。

【請求項2】 金属薄膜がコーティングされた炭素粉末 とシリコン樹脂を、有機溶剤と混合してなる混合物に、 1 種または2 種以上の絶縁性あるいは半導体性粉末を添 加し、該混合物を耐熱性絶縁性基体の表面に形成された 少なくとも1対の電極にその一部が重なるように塗布 し、発熱体被膜を形成し、次いでこれを250℃~45 0℃の温度で焼成することを特徴とする奪或は正の抵抗 ー温度特性を有する面状発熱体の製造法。

【請求項3】 金属薄膜がコーティングされた炭素粉末 とシリコン樹脂を、有機溶剤と混合してなる混合物に、 金属薄膜がコーティングされてない炭素粉末を添加、混 合し、該混合物を耐熱性絶縁性基体の表面に形成された 20 少なくとも1対の電極にその一部が重なるように塗布 し、発熱体被膜を形成し、次いで250℃~450℃の 温度で焼成することを特徴とする零或は正の抵抗ー温度 特性を有する面状発熱体の製造法。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は抵抗ー温度特性が奪 成は正の特性を有する面状発熱体の製造法に関すするも のである。さらに詳細に述べると、炭素粉末を主体とし た導館粒子を用いる面状発熱体の製造法に関するもので 30 ある。

## [0002]

【従来の技術】現在、面状発熱体は電気カーベット、セ ラミックスファンヒータ等民生用機器や配管、タンクの 保温等の産業用の熱源として広く使用されており、その うち民生用としての将来は、その薄さの特徴を生かした 壁や床暖房等としての応用が検討されている。その構造 は発熱部、温度制御部および過熱したときの電源を断つ 安全装置部より構成されている。面状発熱体を大別する と、1) 導電性粒子を熱可塑性樹脂中にブレンドしたも のをシート状に成形したもの、2) 導煙性粒子をシリコ ン樹脂やフリットガラスと混合し、有機ビヒクルを混ぜ 耐熱性絶縁性基材上に密布し焼成したもの、3) チタン 酸パリウムやチタン酸鉛酸パリウム等の成形体を焼成し たそのもの自体が正の抵抗ー温度特性(PTC特性)を 示す発熱体や、4)耐熱性絶縁性基材上にエッチング法 等でパターンニングした金属薄膜を張り付けたもの等が ある。

【0003】すなわち、1)のものは、特公昭54-1

2 ボリオレフィン樹脂等の熱可塑性樹脂にカーボンブラッ クをブレンド・混練し、シート状あるいは緑状等に成形 したもので、樹脂中にカーボン粒子が物理的に配合され 物理的接触のみで導通が得られているようである。導盤 粒子であるカーポンと熱可塑性樹脂との熱膨張係数は樹 脂のほうが極端に大きく、かつ、樹脂はガラス転移点以 上でさらに大きい熱膨張係数を示すため、ブレンドされ たカーボン粒子の間隔が温度の上昇と共に広がり、ガラ ス転移点より上ではその広がりが加速されるため抵抗値 10 が大きくなり顕著なPTC特性を示し、その温度前後で 発熱体に電流が流れなくなり、自己温度制御特性をもっ ているため、それらのものは霓気毛布、ホットカーペッ ト等の商品として広く実用化されている。

【0004】また、2)のものは、例えば特公昭58-15913に聞示されているものがあり、その詳細はシ リコン樹脂ワニスにグラファイト粉末、有機溶剤、流動 性調整材等を混合し、耐熱性絶縁性基材上に塗布し、2 50℃~450℃で3時間焼成し製造する方法が記述さ れている。記述内容では表面温度が200℃~360℃ までの面状発熱体が作成出来ると示されており、各種基 材に強固に接合されており、抵抗値の安定性も良いと明 記されている。また、特公昭38-17827には、ホ 一口一被覆軟鋼板の絶縁性基板等上に黒鉛または金属チ タン或はその混合物とフリットガラスを混合、ペースト 化し、前記絶縁性基板上に塗布、焼成、その上に絶縁保 護の目的で透明性のホーローを施した構造のものが開示 されている。また、公知のものとしては99%~94% アルミナ抵板上に、銀・バラジウム粉末或は酸化ルテニ ウム粉末とガラスフリット及び有機溶剤を混合し、ペー スト化したものをスクリーン印刷法で印刷し焼成して発 熱体を形成し、その上に絶縁保護のため前記フリットガ ラスより低軟化点のガラスを印刷・焼成する構造の厚膜 法が一般的に知られており、特殊な面状加熱装置として 使用されているようである。しかし、熱転写印刷方式ブ リンターのインクシートからインクを紙に転写するため のヒーター、即ちサーマルヘッドには前記厚膜方式の面 状発熱体が便用され、大量に生産され各種熱転写プリン ターのキーデバイスとなっている。

【0005】また、3)の焼結体自体が発熱体であり、 かつ、PTC温度特性を持つチタン酸パリウム系螺子 は、該森子のキューリー点以上の温度で抵抗値が極端に 上昇する特異な温度抵抗値特性を有しており、かつ、そ のキューリー点がチタン酸バリウム中のパリウムをスト ロンチウム、カルシウム或は鉛等で部分的に置換するこ とにより常温付近から300℃位まで変化制御できるた め、洗濯機の乾燥機、布団乾燥機、温風ヒーター等の各 **秵熱源に広く用いられている。4)のものはステンレス** 薄膜やアルミニウム薄膜をエッチング法や、機械的アレ ス法で細い線幅のパターン状に成形し、それを絶縁処理 3625などに関示されているように、ポリエチレンや 50 を施したアルミニウム板やホーロー基板等にシリコン樹

(3)

特開平9-190873

3

脂や無機接着材で張り付けたものが開発されており、一部掘こたつの補助ヒーターとして商品に応用されたものが知られている。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課题】前記した従来の種々の 構成の面状発熱体は多くの課題を抱えている。すなわち 前記1) 記載の熱可塑性樹脂にカーボンブラックをブレ ンドし成形したものは、熱可塑性樹脂とカーボンブラッ クとの熱膨張係数の差が大きく、かつ、樹脂のガラス転 移点以上の温度では急激に膨張が大きくなるため、発熱 10 体の温度上昇とともに樹脂中のカーボンブラック粒子同 士の接触が離れてゆき、抵抗値が大きくなる。即ち、P TC特性を有するという優れた特徴をもち、安全性の大 きい発熱体といえる。しかし、本構成の発熱体は熱可塑 性樹脂を媒体に用いているため、発熱温度に制限があ り、実用的には80~100℃が限界であるといわれて おり、より高温を必要とする暖房用、乾燥用等には能力 不足であり利用範囲が大幅に制限される。また、2)で 記述した特公昭58-15913、グラファイト粉末を シリコン樹脂に混合、焼成したもの、および特公昭38 - 17827、グラファイト粉束とフリットガラスを混 合し焼成したものは、導電粒子であるカーボン自身の抵 抗温度係数が負(結晶黒鉛 a 軸:90×10-4/℃、c 軸:-400×10→/℃、多結晶黒鉛:-10×10 →/℃)であるため、負の温度-抵抗値特性(NTC特 性)を有するものである。

【0007】NTC特性を示す発熱体に電源を供給する と、温度上昇とともに発熱体の抵抗値が低下してゆき、 その結果電流が温度上昇とともに増大し、発熱体はさら に温度上昇をするという悪循環を繰り返し、温度制御し ているセンサーが故障した場合には発熱体が暴走し発熱 体が焼き切れる。これは安全性という面からみると火災 の原因となり、商品を提供する側からは最も重大な欠点 であり、一般的な発熱体として難点がある。また、サー マルヘッドに使われている銀・パラジウム或は酸化ルテ ニウム系発熱体を用いたものは、96%アルミナ基板に 適合できる熱膨張係数の発熱体であるため、より熱衝撃 に強い基板(熱膨張係数が小さい基板、例えば結晶化ガ ラス基板: 13×10<sup>-7</sup>/℃) に前記ペーストを適用す ると、前記ベースト中の銀、パラジウムとの熱膨張係数 40 の差が大きくなるため、発熱抵抗体膜にマイクロクラッ クが発生し、使用中に抵抗値が徐々に増加し初期の温度 を示さなくなる。96%アルミナ基板は基板内の温度分 布の最大部と最小部間の温度差が約100°C以上になる と基板が割れることがあり、特に表面温度250℃以上 の面状発熱体の基板としては安全面で課題がある。

【0008】また、3)に示したチタン酸バリウム系焼結体は、それ自体で自己温度制御でき、かつ、常温からの昇温時はNTC特性を示すのが一般的なので、瞬時に多大の電流が流れキューリー点の温度に速すると急峻な

PT C特性を示し温度上昇をストップし、そのキューリー点付近で自己温度制御するという優れた特性を有しているが、その焼結体のサイズが小さく、広い面積の面状発熱体に適用するためには、多数個の案子を並べる必要があり、非常に高価なものとなり民生用の面状発熱体には不向きである。また、120℃以上のキューリー点にもってゆくためにはバリウムの一部を鉛で置換しなければならず、250℃程度であれば30モル%も置換しなければならず、環境汚染上難点がある。

【0009】また、前記4)に示した金属箔を抵抗バターンに加工し、耐熱性絶縁性基板に張り付けた構造のものは、使われている金属箔がアルミニウムやステンレススチールがほとんどであり、金属の熱膨張係数が大きいため選板はホーロー鋼板がほとんどであり、ピンホールの無いホーローコーティングが難しく豊産化されていないのが現状と思われる。絶縁性セラミックス基板等である。また、ポリエチレンテレフタレート(PET)の薄板でアルミ箔バターンをサンドイッチした面状発熱であり利用できる範囲が大きく制限されている。本発明は前記した種々の問題があるなかで特に、炭素粉末を導電粒子に用いる面状発熱体の改良に関し、温度一抵抗値特性が正の発熱体の製法を提供することにある。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】このような従来の問題点を解決するため、本発明の面状発熱体の製造法は、金属薄膜がコーティングされた炭素粉末とシリコン樹脂を、有機溶剤と混合してなる混合物を、耐熱性絶縁性基体の表面に墜布し、次いでこれを250℃~450℃の温度で焼成して、表面に発熱体被膜を有する零或は正の抵抗一温度特性の発熱体を得るものである。

#### [0011]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明 は、金属薄膜がコーティングされた炭素粉末とシリコン 樹脂を、有機溶剤と混合してなる混合物を、耐熱性絶縁 性基体の表面に形成された少なくとも1対の電極にその 一部が重なるように塗布し、発熱体用被膜を形成し、次 いでこれを250℃~450℃の温度で焼成することを 特徴とする考或は正の抵抗ー温度特性を有する面状発熱 体の製造法であり、本質的に負の抵抗ー温度特性を示す 灰素粉末の表面に正の抵抗-温度特性を示す金属を薄く コーティングされた炭素粉末を導電性粒子に用いるた め、コーティングした金属膜のほうが電気抵抗が低く電 流は大部分金属膜を流れるため、抵抗-温度特性は金属 膜の特性が主体的に現れコーティングした金属材料の温 度特性により数百~数千ppmのPTC特性を示す発熱 体を提供することが可能となる。さらに、炭素粉末表面 にコーティングされた金属膜は薄いため、その粒子の熱 膨張係数は炭素粉末の値をほぼ示し、耐熱衝撃性の大き

特別平9-190873

5

い基板 (例えばセラミックス) としての絶対条件は熱態 張係数が小さいことであるため、熱膨張係数の小さい炭 素粉末を用いることは基板の熱膨張係数に近付けること となり、熱衝撃による発熱体膜の剥離やマイクロクラッ クを発生させない電気的に安定した面状発熱体を提供す ることができる。

【0012】また、請求項2に記載の発明は、金属薄膜 がコーティングされた炭素粉末とシリコン樹脂を、有機 溶剤と混合してなる混合物に、1 種または2 種以上の絶 緑性あるいは半導体性粉末を添加し、該混合物を耐熱性 10 絶縁性基体の表面に形成された少なくとも 1 対の電極に その一部が重なるように塗布し、発熱体彼膜を形成し、 次いでこれを250℃~450℃の温度で焼成すること を特徴とする零成は正の抵抗ー温度特性を有する面状発 熱体の製造法であり、金属膜をコーティングした炭森粉 末とシリコン樹脂との混合比を変えるか、金属膜をコー ティングした炭緊粉末とシリコン樹脂との混合物に、さ らに絶縁性の粉末を添加した混合物と有機溶剤でペース ト化したものを耐熱性基板に塗布、焼成したものは、発 熱体の抵抗値を変えることができ、かつ、抵抗 – 温度特 性はPTC特性を保った状態で種々のワット数の発熱体 を提供することができる。

【0013】さらに、請求項3に記載の発明は、金属薄膜がコーティングされた炭素粉末とシリコン樹脂を、有機溶剤と混合してなる混合物に、金属薄膜がコーティングされてない炭素粉末を添加、混合し、該混合物を耐熱性絶縁性基体の表面に形成された少なくとも1対の電極にその一部が重なるように塗布し、発熱体被膜を形成し、次いで250℃~450℃の温度で焼成することを特徴とする等或は正の抵抗ー温度特性を有する面状発熱ないまする策略は正の抵抗ー温度特性を有する炭素粉末を添加したペーストより形成した発熱体は、添加する炭素粉末の最を金属コーティングした炭素粉末に対して増やしてゆくに従って、炭素自体の持つ負の抵抗ー温度特性が加味され抵抗ー温度特性値が小さくできる事が可能となり、目的とする発熱体の特性に併せてPTC特性を調整することができる。

【0014】(実施の形態)以下本発明を詳細に説明する。シリコン樹脂と金属コーティングされたグラファイト粉末とを混合し、これにピヒクル (有機溶剤、粘度調整剤、分散剤、チクソ性剤等を混合したもの)を加える本ロール混練機で混合しペーストを調整する。前記シリコン樹脂としてはシリコン樹脂ワニス、例えば東芝シリコン(株)製「TSR-116」があり、50%がシリコン樹脂である。このシリコン樹脂製ワニスはトルエンやキシレンで希釈することができる。ペーストの粘度関節はトルエンやキシレンで行うより前記ピヒクルを用いるほうがよい。なぜならば、トルエン等で粘度調節すると英板に塗布するとき粘着性が無くなり、スクリーン印刷などしたときには基板にペーストが転写されず、スク50

リーンについたままとなり塗膜形成ができない。グラファイト粉末に金属コーティングする方法は稠々あり、例えば無電解メッキ法、スパッター法、金属溶射法などがあり、コーティングする金属としては、グラファイトより電気電導性がよく、空気中で安定なものがよく、具体的には銀、金、白金、ニッケル、コパルト、クロムあるいはチタンなどがよい。本実施の形態では Novament Coated Graphite-60 (商品名) を用いた。本材料はグラファイトの表面にニッケルをコーティングしたものであり、平均粒径は約100 $\mu$ m、密度 1.6g/cm²表面抵抗 0.5 $\Omega$ /square の材料である。

【0015】さらに発熱体の抵抗値を調節するために、 1 種或は2種以上の絶縁性あるいは半導体性の粉末を加 えた。このような粉末としては酸化珪素、酸化チタン、 酸化ニッケル、酸化ルテニウム、酸化銅あるいは導電性 を有する金属の窒化物(TiN、ZrN etc)、炭化 物(TiC、ZrC etc)、珪化物 (MoSi、TiS i etc) が有用である。また、抵抗ー温度特性調整用 にはグラファイト粉束を加えた。本実施の形態では日本 **黒鉛(株)製グラファイトHAG-15を用いた。前記** した材料を混合し調整したペーストは、耐熱性絶縁性基 材、例えば、石英ガラス、低熱膨張係数結晶化ガラス、 パイレックスガラス、セラミックス基板(アルミナ、ム ライト、ステアタイト等)などの表面に塗布される。塗 布方法としては、刷毛塗り、スプレー吹き付け、浸せき あるいは印刷法等があるが、本実施の形態では板厚20 0 μmの金属マスクを用いたスクリーン印刷機で印刷し **製造した。ペーストを印刷した基板は120~150℃** の乾燥機で10分乾燥し、電気炉で250℃~450℃ の範囲で焼成した。このようにして製造された発熱体膜 は基材と強固に接着されており、温度サイクルにおいて も剝離やマイクロクラックは生じなかった。また、抵抗 ー温度特性はPTC特性を示し、数百~数千ppmの晩 囲で調整できた。また、金属コーティングされた炭素粉 末の粒径は、5~150μm程度が発熱体用抵抗材とし て最適であった。  $5 \, \mu$ m以下だと炭素に対して金属の比 **率が大きくなり、主に金属の物理的特性を示し不適当で** あった。また、 $150\mu$ m以上だとペースト化が困難 で、かつ、印刷しづらくなる。以下、本発明を実施例に 従って詳細に説明する。

【0016】(実施例1)金属ニッケルがコーティングされたグラファイト粉末(Novament Nickel Coated Graphite-60)、シリコン樹脂ワニス(東芝シリコン(株)商品名TSR-116)及び有機ピヒクルを(表1)の試料No.1に示した組成比で混合した。比較のため無コーティンググラファイト粉末(日本黒鉛(株)HAG-15)と前記シリコン樹脂ワニス、ピヒクルを(表1)の試料No.5に示した組成で混合し、それぞれをバイレックスガラス基板に、膜厚が200μmのメタルマスクを用いたスクリーン印刷機で印刷し、150℃、10分

(5)

76.9

特開平9-190873

8

w t %

乾燥した。 【0017】

\*【表1】

\*

成分 1 2 3 4 5

PM3>耐服7=1
(TSR-115) 7.7 13.3 23.5 13.3 57
耐磁分: 約50%

 グラファイト粉束
 2.7
 43

 酸化ニップが粉束
 6.7
 5.9
 6.7

 石機じ ヒクみ
 15.4
 13.3
 11.8
 10.6

66.7

【0018】これを200℃-1時間 350℃-2時間の2段プロファイルで焼成した。昇温速度は100℃ /30分で行った。抵抗体のサイズは、20×20m m、厚み約300μmであった。このようにして作成し※

7

テッケル被覆がラファイト粉

※た発熱体の抵抗値-温度特性の結果を(表2)の試料N0.1、5にそれぞれ示した。【0019】

【表2】

58.8

R 2 ]

単位: Ω

66.7

耐定過度	区料NO	1	2	э	4	5
25℃		0.168	0.78	2.31	4.75	14.39
5 0	± 2	0.20	0.84	2.57	4.89	14.21
100	± 6	D. 26	0.98	2.90	Б. 05	13.67
150	± 5	0.30	1.07	3,27	5.32	19,34
200	± 5	0.37	1.24	3.56	6.49	13.18
250	± 5	0.42	1.38	3.84	5.66	13.04
抵低温度係数 25~250で ppn/で		+ 5667	+ 3419	+ 3136	+851	- 417

【0020】表中抵抗温度係数はJIS規格C-560 ★【0021】 2に規定されている下記式にて算出した。 ★

抵抗温度係数pi

 $ppm/C=R-R_o/R_o\times 1/t-t_o\times 10_e$ 

(6)

符開平9-190873

9

R : t ℃における抵抗実測値 Ω
R。: t。℃における抵抗実測値 Ω
t : 試験温度の実測値 ℃
t。: 基準温度の実測値 ℃

(表1)の試料No.1の発熱体の抵抗温度係数は、

(表 2) のN o. 1 に示したごとく、正の温度特性を示し、6600ppm/℃と非常に大きなPT C特性が得られた。比較のために(表 1) の試料N o. 5のグラファイトのみについてのそれは、(表 2) のN o. 5 に示したごとくー400ppm/℃とNT C特性を示し予想 られた。本抵抗膜はパイレックスガラスに強300℃であった。本抵抗膜はパイレックスガラスに強300℃で断続通電試験をしたが、発熱体膜の剥離やマイクロクラックは生じてなかった。本抵抗体は非常に抵抗温度係数が大きいので電源投入時に大きな電流が流れ温度が上昇すると抵抗値が大きくなり、完ぺきではないが温度 制御を行うことを確認した。これは従来のグラファイトのみで形成した発熱体膜と正反対の特性であり、安全性の高い発熱体を提供できることが実証できた。

【0022】(実施例2)本発明の第二の実施例について、次に詳細を述べる。金属ニッケルがコーティングされたグラファイト粉末とシリコン樹脂ワニス(実施例1で記述のものと同じ)と酸化ニッケル粉末および有機ビヒクルを(表1)の試料No.2、3に示した割合で混合し、ペーストを作成した。試料No.2と3の違いはシリコン樹脂ワニスの添加量を変えたものである。このようにして作成したペーストを、パイレックスガラス基板上に厚さ200 $\mu$ mの金属マスクを用い、スクリーン印刷機で印刷、抵抗体バターンを形成し、150  $\mathbb C$ 、10分乾燥後、200 $\mathbb C$ ・1時間  $-350\mathbb C$ ・2時間、分乾燥後、200 $\mathbb C$ ・1時間  $-350\mathbb C$ ・2時間、分乾燥後、200 $\mathbb C$ ・1時間  $-350\mathbb C$ ・2時間、最近体のサイズは20×20mmである。試料No.2、3の温度 - 抵抗値の関係は(表2)のNo.2、3に示した。

【0023】(表2)に示したごとく、酸化ニッケルを 添加することにより抵抗値を増加することができ、ま た、シリコン樹脂ワニスの添加量でも抵抗値の制御がで きることが確認できた。実際の発熱体を製造するとき は、ペーストの抵抗値を希望値に合わせることは重要で あり、これが出来ないと物は作れない。また、肝心な抵 抗温度係数は3000ppm╱℃程度のPTC特性を示 し、安全性のある発熱体被膜を形成できるベーストであ ることが立証できた。また、実際の面状発熱体を作成し て性能を調べたが何等問題なく使用できることがわかっ た。また、抵抗値調整のための添加粉米については、稠 々検討を重ねたが、次に示す材料であれば本災施例に示 したのとほぼ同じ効果が得られることがわかった。その 材料は、酸化珪紫、酸化チタン、酸化ルテニウム、酸化 銅や金属の窒化物、炭化物あるいは金属のシリサイドな どが有効であることが立証された。

10 【0024】 (実施例3) 本発明の第三の実施例について、次に詳細を述べる。

【0025】金属ニッケルを被覆したグラファイト粉末 とシリコン樹脂ワニス(実施例1に記述したのと同じも の)と酸化ニッケル粉末に、金属被覆してないグラファ イト粉末(日本黒鉛(株)製:商品名HAG-15)お よび有機ピヒクルを(裘1)の試料No.4に示した組 成比で混合しペースト化したものを、パイレックスガラ ス基板上に実施例1と同じ方法、条件で発熱体被膜を形 成し、その特性を調べた。その結果を(表2)のNo. 4 に示した。即ち金属被膜なしのグラファイトを加えて ない実施例1、2の発熱体被膜の抵抗温度係数は300 0 ppm/℃程度であったのが、本実施例の結果では8 00ppm/℃と低くなっており、この結果は無コーテ イングのグラファイト粉末を、金属コーティングしたグ ラファイト粉末に適量加えることにより、抵抗温度係数 を自由に調整できることを示している。極端にいえば、 抵抗温度係数が0~6000ppm/℃の発熱体被膜を 製造できることを確認したことである。

」【0026】本実施例では全て金属ニッケル薄膜をコーティングしたグラファイト粉末について説明したが、空気中常温~300℃程度の範囲である程度の保護コーディングを施せば抵抗値変化の無い、かつ、電気の良導体で、その金属の融点が5、600℃以上のものであれば、なんら制限されるものではないことは言うまでもない。それに該当する代表的金属としては、金、銀、ニッケル、白金、コバルト、アルミニウム、チタンなどがある。また、本実施例では基板材料にバイレックスガラスを用いたが、本材料の熱膨張係数は、32×10<sup>-7</sup>/℃であり、その耐温度差特性において、約150~200℃の温度差が基板に加わると基板は破壊される。

【0027】従って、より熱衝撃のきつい、かつ、より 高い発熱温度を必要とする面状発熱体の基材には使用で きず、より熱膨張係数の小さい基材を使用しなければな らない。それに合致する材料としては、石英硝子 (熱膨 張係数:5×10<sup>-7</sup>)や低熱膨張性結晶化硝子 (熱膨張 係数: $13 imes10^{-7}$ )が適当であるが、それに適した発 熟体被膜としては、実施例で示した材料よりさらに低熱 膨張の彼膜を形成する必要がある。それを満足するため には、グラファイト粉束をガラス状カーポン粉末に変更 し、それに金属コーティングを施したものを用いてペー ストを作る必要がある。ガラス状カーポンの熱膨張係数 は、20~30×10<sup>-7</sup>であり、グラファイト材料の約 1/3の膨張係数値である。本ガラス状カーボン粉末に 金属銀あるいはニッケルをコーティングしたものを用い て本実施例に比して発熱体被膜を形成し、その特性を調 べたが、炭面にコーティングした金属被膜が、抵抗温度 係数にほぼ関与するため、本実施例に近似したPTC特 性を示した。また、日本電気硝子(株)製低熱膨張結晶 50 化ガラス基板にガラス状カーボンを用いたベーストを用

(7)

特開平9-190873

11

いて発熱体被膜を作成し、実働試験を施したが基板から の発熱体被膜の剥離や抵抗値の変動等異常は起こさなか った。

## [0028]

【発明の効果】以上のように金属薄膜をコーティングし た炭素粉末を用いた発熱体被膜は、従来のグラファイト たけのものが示したNTC特性をPTC特性に変換する ことに成功し、火災や異常加熱の起こらない安全な発熱 体被膜用材料およびその製造法を提供することができる ようになった。また、絶縁体や半導体粉束を加えること 10 ウハウをそのまま適用し、安全で低価格の面状発熱体が によりPTC特性を大きく狂わす事なく発熱体被膜の抵 抗値を自由に調節することができた。さらに、金属コー

ティングの施してないグラファイト粉末を金属コーティ ングを施した粉末に適量添加することにより、抵抗温度 係数を自由に調整することが可能となった。これまで随 分古くから特許公報上では多くのグラファイト系導電粒 子を用いたものが開示されてきたが、その割には商品が 出現してないのが現状であり、その大きな契因の一つに 発熱体被膜がNT C特性を示し、その改善がなされなか ったためと思われる。本発明によれば、従来のグラファ イトを用いた面状発熱体を形成する多くの蓄積されたノ 提供できる。

12